レビュー

第3回「九州」半導体産業展（上）

1万人超の来場者数が継続
新設の設計パビリオンも盛況

会場の様子

9月30日～10月1日の2日間、「第3回「九州」半導体産業展」が、福岡市のマリンメッセ福岡A館とB館で開催された。500社分の出展枠はすべて完売し、来場者は2日間で1万人を超える大盛況となった。

第3回となる今年の開催では、新たに「半導体設計パビリオン」が設置され15社が出展した。初出展の日本アイ・ビー・エム㈱は、2nmプロセス技術を用いたAIアクセラレーターや半導体設計にも対応したAI駆動開発ソリューションなどをパネルで展示した。同じく初出展のTOPPAN㈱は、LSIターンキーサービスなどを紹介。

同パビリオンの設置はこれまで出展が叶わなかった設計業者の参加のきっかけになったようだ。また、特設セミナー会場も併設され、講演も満席の大盛況だった。多くの参加者の関心の高さをうかがうことができた。

さらに今回は、九州全県によるパビリオンの出展が実現。加えて近隣の山口県や広島県も出展した。山口県下関市のパビリオンでは、半導体市場での販路拡大を目指して金属加工技術を有する5社が共同出展した。なかでも、㈱カワグチは高精度な加工技術を紹介したほか、㈱まるわステンレス工業は少量多品種に対応した金属加工の事例を展示した。両社ともに半導体装置部品実績を有し、今後さらなる拡大を目指す。

過去2回の出展効果により、九州市場の拡大を見据えて出展した企業も引き続き多く見受けられた。例えば、めっき加工を行う㈱三ツ矢は、半導体向け製品の販売比率向上に向け、接点の獲得につなげているとしたほか、SMC㈱も同様に、九州での半導体市場の盛り上がりを受けて認知度の確認や新規顧客開拓を目的に初出展した。同社はCO_2冷媒を採用した冷凍式サーモチラー「HRZC」シリーズを紹介。海外を中心に高まる冷媒規制に対応した新製品となっている。

また、i-PEX Piezo Solutions㈱は、単結晶チタン酸ジルコン酸鉛（PZT）成膜技術を活用した圧電MEMSファンドリー事業を紹介した。福岡県小郡市のI―PEXキャンパス内に7月にクリーンルームを新設・稼働した。ファンドリー事業のさらなる成長と需要拡大に対応し、九州での顧客獲得に力を入れるとし、展示ではPZT単結晶積層薄膜ウエハーなども展示した。

光電融合に関する展示も目立った。半導体や各種センサー向けの後工程の受託開発・製造を手がけるコネクテックジャパン㈱（新潟県妙高市）は、放熱関連の開発にも注力していく方針だとして、新たに開発したCPO&チップレットの放熱化技術「チャート」を紹介。積層構造パッケージ内蔵CPOおよびチップを高効率で放熱する。従来ヒートシンクを活用していたが、今回開発した新構造では、新たに開発した放熱構造体である、金属や冷媒といった高熱伝導冷却パターンを積層構造パッケージの各層に設置し、熱を横方向に拡散して放熱する。

ヒートシンクが不要になるため、モジュールの小型化にも貢献する。また、チップの大型化による熱課題の解決にも貢献できる。2027年から本格的に対応可能となるそうだ。

（日下千穂記者／石井大成記者）

半導体設計パビリオンのセミナースペースも盛況

SMCの冷凍式サーモチラー「HRZC」